

## マニュアルボールワイヤーボンダ

LED ペアチップ(数百 $\mu\text{m}$ 角)等の半導体と回路基板を熱と圧力と超音波によって結線する装置

### 【型式】

WESTBOND 7700D

### 【仕様】

ボンディング方式	: US・TC 又はサーモニック方式
操作方法	: 3 軸マニピュレータ
荷重	: 10~100g
超音波	: 最大 4W, 999ms, 63kHz (固定)
金線	: 25 $\mu\text{m}$ $\phi$
ワークホルダー範囲	: 最大 50mm $\times$ 50mm
搭載機構	: デュアルフォース機構, ボールサイズコントローラー, 温度コントローラー, ワイヤードイスプーラー

### 【設置年度】

2012 年度 (平成 24 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問, 設備利用の手続き等は, [センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 12 日